

令和3年度

京都実装技術研究会 第5回例会

京都実装技術研究会は、昭和62年に発足し、電子機器の生産に深く関わる基盤技術である接合・実装技術を中心に、生産現場の高度化のために必要な課題や各社が抱えている共通の問題をテーマにした活動を行い、参加企業の技術水準向上に努めています。

この度、本年度第5回例会として、数多くの現場で実装技術支援を務めてこられた講師の方をお招きしてご講演いただきます。皆様のご参加をお待ちしております。

◇ 開催日時 令和4年3月3日（木） 13:30 ~ 16:00

◇ 開催方式 Web/会場参加 併用

◇ 会場 京都府産業支援センター 5階 研修室
(京都市下京区中堂寺南町134 京都リサーチパーク東地区内)

◇ 内容

「量産現場における鉛フリーはんだ」

講師：実装技研 実装技術アドバイザー 河合 一男 氏

リフロー工法変更によるコスト・品質の改善実験を行った経過および
フローはんだ付けの問題と対策について、以下の項目でご講演いただきます。

I リフロー工法変更によるコスト・品質の改善実験経過

1 ディスクリット部品のリフロー化

- ・ 温度プロファイルの作成
- ・ 印刷によるはんだ供給

2 耐熱性の低い部品のリフロー化

- ・ パレットの活用
- ・ 放熱治具の活用

3 BGA/QFNのボイド

- ・ ボイドの主な発生原因と対策

II フローはんだ付けの問題と対策

- ・ パレットの改善効果

◇ 定員 Web：応募状況により調整 会場：30名

◇ 参加費 会員：無料 非会員：10,000円
(研究会入会希望の方は事務局までお問合せください。年会費20,000円/社)

◇ 申込締切 令和4年3月1日（火）まで

◇ 問合せ先 京都府中小企業技術センター 応用技術課 電気通信係
(京都実装技術研究会事務局)
TEL 075-315-8634 FAX 075-315-9497
E-mail jisso@kptc.jp

令和3年度 京都実装技術研究会 第5回例会申込書

会社名		
所在地		
連絡担当者	所属・役職	
	氏名	
	E-mail	
	電話番号	
参加者	所属・役職	氏名
参加方法	<input type="checkbox"/> Web 参加 <input type="checkbox"/> 会場参加	

※申込書にご記入いただいた個人情報は、本研究会受講者名簿として活用させていただきます。

受講に当たっての注意点

- Web参加は、1 事業所 1 接続でお願いします。複数名で参加される場合は、プロジェクターやスピーカー等のご準備をお願いします。
- 録画、録音等の配信データの記録、保存は一切禁止です。
- 会場には消毒液を設置し、会場の窓や扉の開放等による換気、他の受講者との間隔をあける等の対策をいたします。ご来所の際は、マスクの着用と丁寧な手洗い・手指消毒をお願いします。また、発熱等の症状がある方はご来場をお控えください。